

高充填・狭ギャップ対応 半導体封止材用フィラー

○ 特徴

- ・ 当社のコア技術を活用した半導体封止材に適用可能なフィラー設計



✓ 粒子合成技術

高純度、高球形度を実現

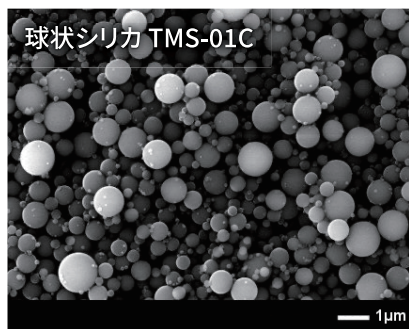
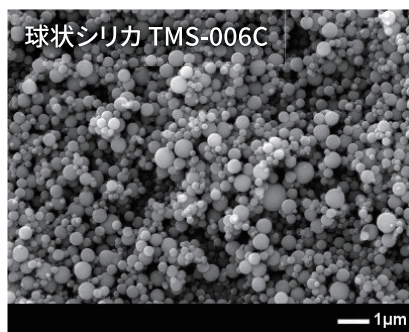
✓ 粒度分布制御技術

高充填且つ狭ギャップ充填可能な
トップカットを両立した粒度分布

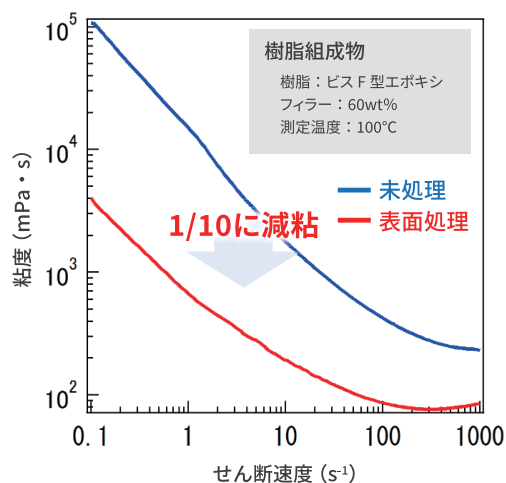
✓ 表面処理技術

有機系（シランカップリング剤等）及び
無機系（AlやTi等）の表面改質により
樹脂との親和性を向上

○ 代表フィラー（シリカ）物性



名称	粒度分布		比表面積 (m ² /g)	Na (ppm)	Cl (ppm)	Fe (ppm)
	D50 (μm)	D100 (μm)				
TMS-006C	0.6	1.9	11	<20	<2	<20
TMS-01C	1.0	3.6	4	<10	<2	<10



シリカ以外にも放熱フィラー（アルミナ、窒化アルミ等）も開発中